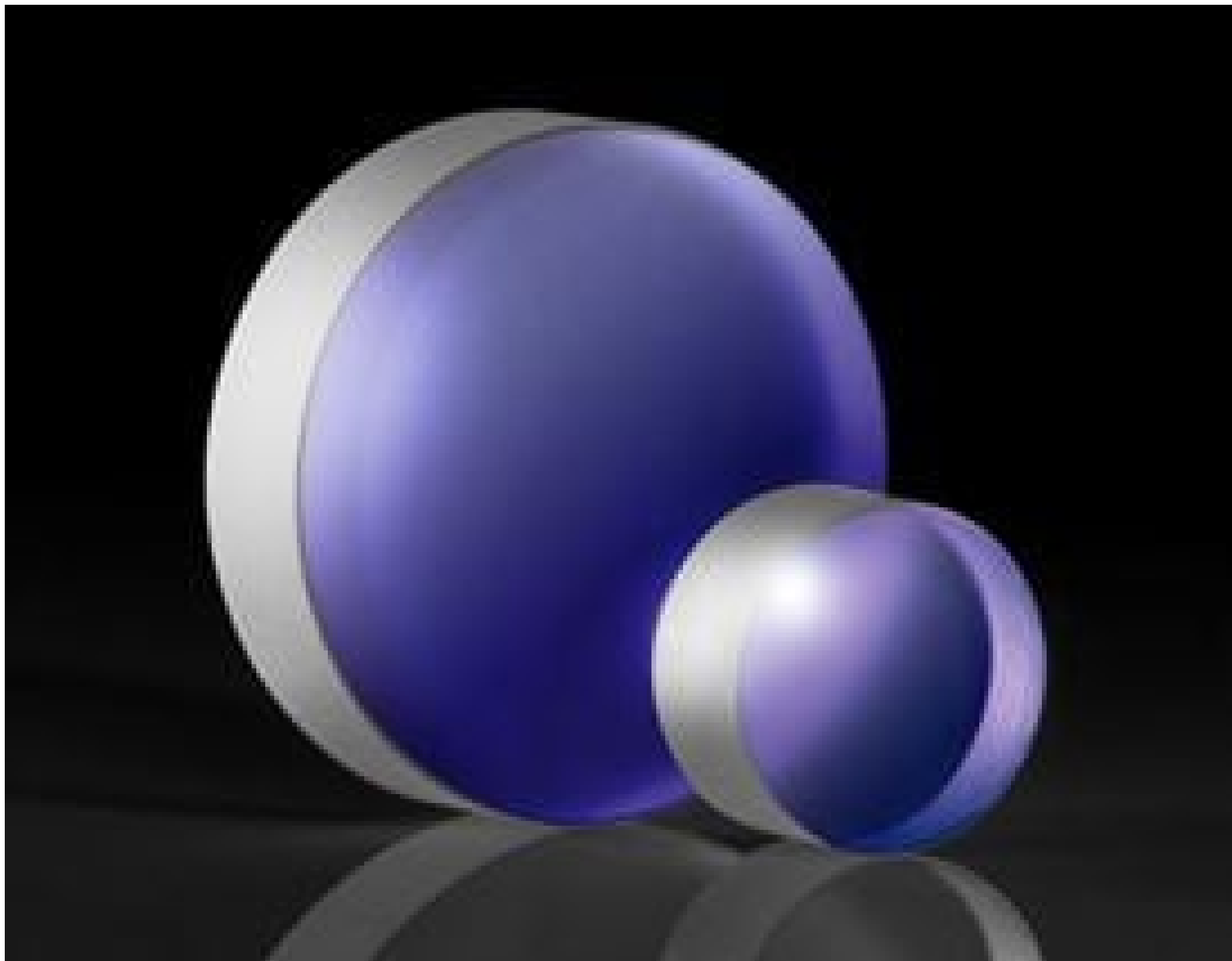


[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Miroir Ti:Saphir en Silice Fondue 800 nm, 12,7 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur, AOI 45 degrés



Stock #28-986 **3 In Stock**

- 1 + €145⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-5	€145,00 prix unitaire
Qté 6-25	€116,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Ti:Sapphire Laser Mirror **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

6.35 ±0.20 **Épaisseur (mm):**

Ouverture Utile CA (mm):

11.43

12.70 +0.00/-0.10 **Diamètre (mm):**

<3 **Parallélisme (arcmin):**

Fine Ground **Bords:**

Propriétés optiques

Fused Silica (Corning 7980) **Substrat:** □

10-5 **Qualité de Surface:**

45 **Angle d'Incidence (°):**

Laser Mirror (800nm) **Traitement:**

800 **Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):**

780 - 820 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

λ10 **Planéité de Surface (P-V):**

Spécification du Traitement:
R_{abs} S & P >99.80% @ 400nm @ 45° AOI
R_{avg} >99.5% @ 390 - 410nm @ 45° AOI

Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Réflectivité >99,8% aux fréquences fondamentales et harmoniques des lasers Ti:saphir
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser
- Seuil de dommage laser élevé

Les Miroirs Raie Laser Ti:Saphir TECHSPEC® offrent une réflectivité de >99,8% pour les fréquences fondamentales et harmoniques du laser Ti:saphir à un angle d'incidence (AOI) de 45° et à un AOI de 0-45°. Ces miroirs laser sont conçus avec un substrat en silice fondue pour une excellente stabilité thermique et sont traités pour 800 nm, 400 nm ou 266 nm qui sont respectivement la fréquence fondamentale et la deuxième harmonique. Pour minimiser les effets de dispersion, ces miroirs présentent une qualité de surface élevée de 10-5 et une planéité de surface de λ10. Les Miroirs Raie Laser Ti:Saphir TECHSPEC® sont idéaux pour une gamme d'applications laser Ti:saphir telles que l'imagerie multiphotonique, la spectroscopie ultrarapide et le micro-usinage à froid.